

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-005

富满微电子集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富满微	股票代码	300671
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗琼	胡江蝶	
办公地址	广东省深圳市前海深港合作区听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 B 座 37 层	广东省深圳市前海深港合作区听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 B 座 37 层	
传真	0755-83492817	0755-83492817	
电话	0755-83492887	0755-83492856	
电子信箱	zqb@superchip.cn	zqb@superchip.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及主营产品简介

公司是一家致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计、研发、封装、测试和销售的国家级高新技术企业。核心产品包括 LED 屏控制与驱动芯片、功率器件（MOSFET/IGBT）、MCU、快充协议芯片、5G 射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类 ASIC 芯片。这些产品广泛应用于消费电子、家电行业，通信设备、工业控制等传统领域，同时也深入物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造及 5G 通信等新兴电子领域。

（2）经营模式

公司是 Fabless（无晶圆厂 IC 设计公司），负责集成电路的设计、封装和测试，而集成电路的制造委托晶圆代工厂生产完成。公司产品采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式面向具有规模的重大客户，致力于快速响应客户需求，深入体贴服务客户，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

（3）业务发展

报告期，公司坚持以市场为导向，持续巩固核心竞争力，通过“技术+市场”双轮驱动策略，不断加大研发投入、优化营销策略，深挖存量业务，积极开拓新业务、新市场 具体如下：

1. 报告期在着力未来市场布局的同时加大功率器件类产品及大功率电源管理类产品研发投入；
2. 通过技术迭代稳固成熟市场产品，扩大市场份额；
3. 通过生产工艺优化提升作业效率；
4. 通过可靠性材料替代、节能降耗等措施，降低生产成本；
5. 结合数据分析，制定有限运营策略，优化产品结构；
6. 推进产线自动化改造和技术革新，加大机器人设备投入，提高人效；
7. 加强品质管控，提升产品良率；
8. 实施股权激励计划，优化薪酬管理体系，助推公司未来经营业绩增长。

（二）集成电路行业现状及发展变化

集成电路产业是推动经济社会现代化和数字化转型的核心支柱，具有战略性、基础性和引领性地位。长期以来，该行业以全球协作为主要特征，各国凭借自身优势参与国际半导体产业链的分工。然而，2024 年全球地缘政治与经济格局的深刻变革，推动各国加速本土半导体产业布局，全球产业链格局进入深度调整阶段。一方面，各国通过芯片法案、补贴政策等手段强化本土制造能力，全球化分工模式面临重构；另一方面，中国半导体产业在成熟制程、特色工艺等领域持续突破，国产化率稳步提升，但仍面临高端技术管制、供应链韧性不足及行业周期性波动的挑战。

从全球范围看，半导体产业在 2024 年依然面临诸多挑战。国际贸易环境的不确定性持续加剧，产业链区域化和碎片化趋势日益明显，地缘政治冲突和区域发展失衡等问题进一步制约了行业的发展速度。2024 年，国内半导体市场结构性分化依然较为明显：一方面，与普通消费电子相关的产品需求复苏缓慢；另一方面与汽车、新能源、人工智能等相关的产品需求较为旺盛；在国家政策的引导下，国产芯片进口替代的进程明显加快。

（三）公司主要集成电路产品的行业竞争情况和公司综合优劣势

集成电路产业主要由设计、封装和测试三大核心环节构成，其中设计环节的技术水平直接决定了芯片的功能、性能以及成本效益，是行业竞争的关键所在。在封装测试领域，中国大陆企业的技术实力已逐步接近国际先进水平。近年来，通过自主研发和并购整合，国内领先企业在先进封装技术方面不断缩小与国际巨头的差距，行业竞争日趋白热化。

公司系国内少数较早实现集成电路设计、封装、测试及销售全链条一体化发展的企业之一，公司潜心专研半导体研发数 10 年，具有深厚的技术积累、及一批稳定的研发团队，在半导体领域拥有数百项核心专利、及软件著作权；在各类细分市场公司产品设计以低功耗、高转换率、高可靠性、高集成等优势彰显竞争力。

公司采用“研发-生产”一体化运营模式，通过垂直整合芯片设计、晶圆制造工艺开发、供应链管理、封装测试等全产业链环节，实现对产品质量、生产效率和成本控制的精准把控。这种深度协同的业态模式不仅保障了产品性能的稳定可靠，更显著加速了科研成果的产业化落地。经过多年精益化运营与技术迭代，公司已建立起行业领先的工艺技术平台，产品在良率、能效比及可靠性等关键指标上均达到行业先进水平，成为细分领域的技术标杆。

公司所处的集成电路行业，系国家鼓励发展的主导型行业，市场消费需求前景广阔，历经数十年深耕细作，公司在渠道建设方面成绩斐然，积累了丰富深厚的资源。目前，公司已与一批长期稳定的客户及合作伙伴建立起紧密的共生关系，各方携手共进，实现了协同成长。

公司构建了严谨完善的治理体系，面对竞争日趋激烈的市场环境，能够凭借科学高效的风险管控机制，精准识别、评估并应对各类潜在风险，为公司运营筑牢坚实防线，确保公司在稳健轨道上持续发展，不断提升市场竞争力与抗风险能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,637,844,177.86	2,913,711,600.25	-9.47%	3,275,223,194.66
归属于上市公司股东的净资产	1,635,527,366.23	1,828,858,879.46	-10.57%	2,183,774,707.35
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	681,675,496.81	701,684,939.75	-2.85%	771,302,586.82
归属于上市公司股东的净利润	-241,509,185.41	-347,914,961.77	30.58%	-172,667,293.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-260,145,189.96	-355,433,849.85	26.81%	-207,339,675.68
经营活动产生的现金流量净额	-49,198,383.49	-46,990,030.41	-4.70%	3,272,505.28
基本每股收益（元/股）	-1.11	-1.60	30.63%	-0.79
稀释每股收益（元/股）	-1.06	-1.52	30.26%	-0.78
加权平均净资产收益率	-13.94%	-17.49%	3.55%	-7.33%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	145,309,833.83	157,488,868.10	192,971,400.10	185,905,394.78
归属于上市公司股东的净利润	-28,210,610.82	-19,608,469.22	-16,987,437.94	-176,702,667.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,906,117.76	-27,342,960.97	-26,591,006.73	-176,305,104.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,897,299.75	47,264,521.63	39,808,837.32	-133,374,442.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,209	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
集晶（香港）有限公司	境外法人	31.65%	68,910,043.00	0.00	不适用	0.00			
李新岗	境内自然人	2.86%	6,221,200.00	0.00	不适用	0.00			
吴晓虹	境外自然人	1.24%	2,697,488.00	0.00	不适用	0.00			
霍鹏冲	境内自然人	1.18%	2,563,020.00	0.00	不适用	0.00			
肖玲	境内自然人	1.04%	2,260,090.00	0.00	不适用	0.00			
康云	境内自然人	0.82%	1,785,000.00	0.00	不适用	0.00			
张亚飞	境内自然人	0.76%	1,655,644.00	0.00	不适用	0.00			
吴玉胜	境内自然人	0.68%	1,482,500.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	1,443,883.00	0.00	不适用	0.00			
刁云景	境内自然人	0.66%	1,440,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份，刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人，共持有本公司股份 4.2%，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

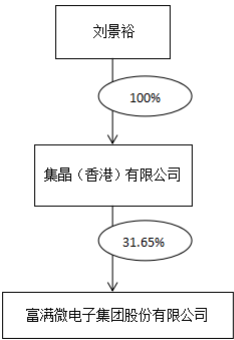
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

无